

陶氏電子材料為印刷電路板市場推出新型解決方案

與客戶的策略合作滿足未來需求

美國密西根州米德蘭 2010 年 11 月 2 日訊 [陶氏化學公司](#) (NYSE: DOW) 旗下業務部門[陶氏電子材料](#)將為印刷電路板 (PCB) 製造商帶來一套新的解決方案。這些新一代技術將幫助客戶不斷提供具有成本效益的優質材料，以滿足未來的市場需求。新的解決方案包括：兩種新推出的用於最終表面處理的產品；以及四種應用於電鍍和通孔金屬化領域、目前處於量產測試階段的新產品。

PCB 最終表面處理：陶氏推出了兩種在最終表面處理階段使用的解決方案，可在導電銅墊表面建立一層鍍層，從而帶來可焊性、打線接合及保護性能。

- [AUROLECTROLESS™ SMT 520 沉金](#)是一種極具成本效益的解決方案，能夠在低金鹽濃度下工作，從而減少 ENIG (化學鍍金) 工藝中金的消耗量。該產品具有出色的沉積覆蓋能力，從而可在後續工藝步驟中增強抗腐蝕性。
- [SILVERON MF™ 100 自催化銀沉金](#)是一種可替代浸銀 (Immersion Ag) 和化學鍍銀 (ENEPIG) 的高性能解決方案。高密度的銀鍍層可防止銅擴散至銀表面，而減少氧化銅的形成，因此有效的抗腐蝕性保證了良好的可焊性及打線接合能力。在銀表面加鍍低厚度沉金則具有優異的金線接合能力，高可靠度的性能是打金線技術的最新選擇。

PCB 電鍍：這兩種正處於量產測試階段的產品旨在滿足高信賴度及細線路市場對電解電鍍的特殊要求。在電鍍階段，可使用這種電鍍添加劑材料形成更均勻及更佳分佈的銅導電層。陶氏新一代厚板銅鍍 (Thick Panel Copper Plating) 可提高極厚板電鍍 (厚度超過 3.2 mm) 的通孔貫孔均鍍能力。高速直流電鍍 (High Speed Direct Current Copper Plating) 產品可應用於細小孔徑高縱橫比和微盲孔電路板，能夠在電鍍密度增加的情況下仍維持很好的均鍍能力。這些產品使用現有設備即可生產，無需投資額外的設備，產品設計均有助於提高電鍍效率，並實現更高的生產產出。

PCB 通孔金屬化：陶氏兩種正處於量產測試階段的新產品可用於通孔金屬化工藝製程，使用這些材料形成初始沉積，隨後在其表面形成電鍍層。

- 首先，先進 SAP 金屬化產品是一種整體 SAP (半加工工藝) 解決方案。其創新的化學性質整合中和劑、整孔劑和化學鍍銅。在低粗糙度下即能具有較高的絕緣層附著力，在雷射盲孔底部和表面都具有出色的鍍層覆蓋力，此外還擁有優異的鍍液穩定性和可靠性能，是目前及下一代超細線路 SAP 的理想之選。
- 陶氏全新先進膨鬆劑產品可提供高成本效益、操作範圍寬的卓越解決方案。新型先進膨鬆劑適用於普通及高性能板材，採用符合環保可持續性的溶劑及低操作濃度。

陶氏電子材料事業群電子互連技術事業部全球總經理張巍表示：“長期以來，陶氏電子材料始終致力於與客戶緊密合作，為這一重要市場提供先進的技術和可靠的客戶服務。這些策略合作為我們客戶的發展提供了保障，並有助於促進當今電子行業的重大進步。”

關於陶氏化學公司

陶氏是一家多元化的化學公司，運用科學、技術以及”人元素”力量不斷改進推動人類進步的基本要素。公司將永續原則貫穿於化學與創新，致力於解決當今世界的諸多挑戰，如滿足清潔水的需求、提高能源效率、實現可再生能源的生產、提高農作物產量等。陶氏以其領先的特種化學、高新材料、農業科學和塑膠等業務，為全球 160 個國家和地區的客戶提供種類繁多的產品及服務，應用於電子產品、水處理、能源、塗料和農業等高速發展的市場。2009 年，陶氏年銷售額為 450 億美元，在全球擁有 52,000 名員工，在 37 個國家營運 214 個生產基地，產品達 5000 多種。除特別註明外，“陶氏”或“公司”均指陶氏化學公司及其附屬公司。有關陶氏的進一步資料，請瀏覽陶氏網頁 www.dow.com.cn 以及 www.dow.com。

關於陶氏電子材料

陶氏電子材料是全球電子產業的材料和技術供應商，引領半導體、[電子互連](#)、[表面處理](#)、[太陽能電池](#)、顯示器、LED 和光學產品領域的發展。透過分佈在世界各地的技術中心，陶氏優秀的研發科學家和應用專家與客戶密切合作，為新一代的電子技術提供解決方案、產品和技術服務。這種緊密的合作關係激發了陶氏的創新發明能力，其關鍵的終端應用領域涵蓋了廣泛的消費性電子產品，包括個人電腦、電視、行動電話、全球定位系統、車輛安全系統和航空電子設備等。

媒體聯絡：

陶氏電子材料
謝嘉雯

電話：+886-37-539158
電郵：elysiahsieh@dow.com